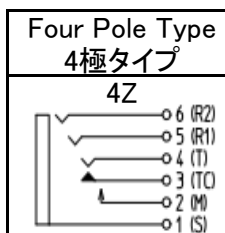


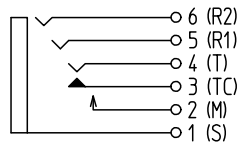
LA7 Series / シリーズ



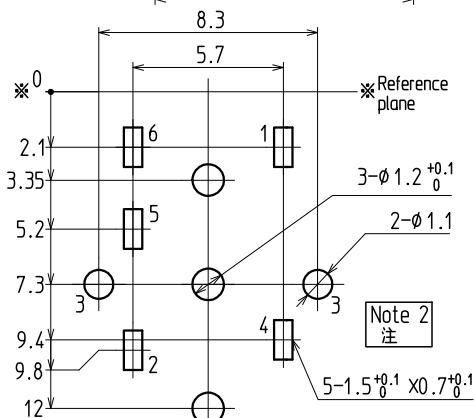
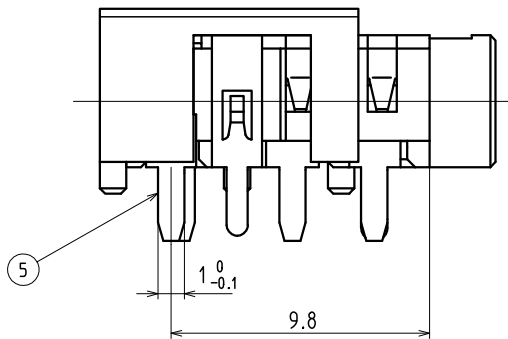
t1.2mm PC Board / 基板	Straight Type / ストレートタイプ	YKB21-5349
	Kink Type / キンクタイプ	YKB21-5422N
t0.8mm PC Board / 基板	Straight Type / ストレートタイプ	YKB21-5361

REFERENCE DRAWING

御参考

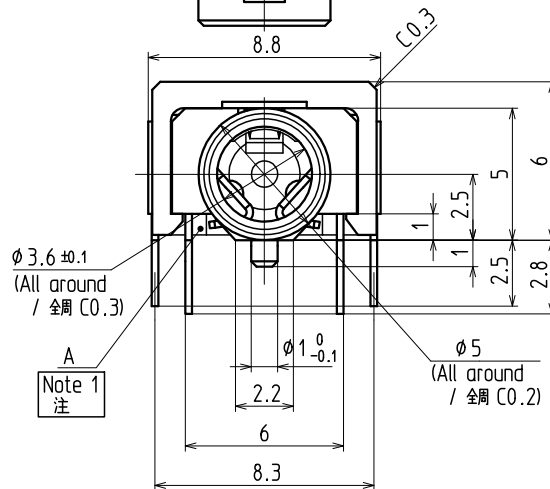
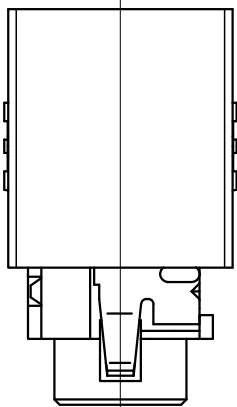


Circuit
回路図



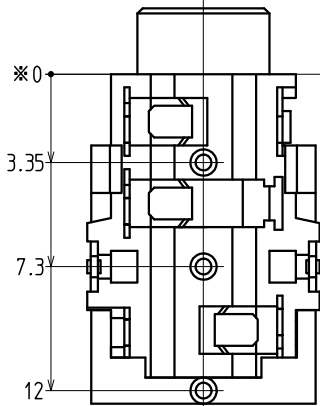
Dimensions of PC board holes
参考基板孔寸法図

(Tolerance All±0.1)(Printed side-view) t1.2
公差



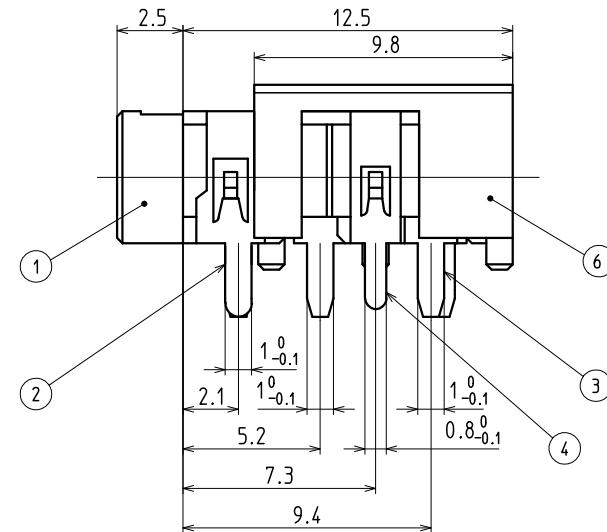
Note 1
注

Reference
plane



Notes / 注記

1. Take care not to let the solder flow into the part of A when you solder a jack with a soldering iron.
半田ゴテにて半田付けする場合は、A部に半田が流れ込まない様にご注意ください。
2. Use a jig tool to fix the jack to a PCB so that it would not suspend from the PCB when you dip the jack into a soldering bath.
半田槽にてディップする場合は、治具等を用いてジャックの浮きが生じない様にして下さい。
3. In case use P.C board of through holes, don't prepare a land in part side.
スルーホール基板を使用する際は、部品面側にランドを設けない事。
4. When soldering in auto soldering bath, it is suggested to check contact failure, appearance failure, etc. by flux before.
自動半田槽にて半田付けを行う際には、事前にフラックス流入による接触不良、外觀不良等の確認をお願いします。



t1.2 type/タ17
With cover type
カバー付タイプ
3.5 DIA LA7

☆ Goods mass / 製品質量 : About / 約 0.7g.

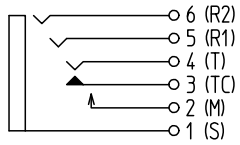
6	COVER カバー		1	PBT GF15% WHITE 白			94V-0		
5	MAKE CONTACT メークパネ		1	BRASS 黄銅	t0.25	(M)			GOLD PLATED
4	TRANSFER CONTACT トランスファパネ		1	PHOSPHOR BRONZE りん青銅	t0.25	(TC)			GOLD PLATED
3	CONTACT コンタクト		3	PHOSPHOR BRONZE りん青銅	t0.25	(T, R1, R2)			SILVER PLATED
2	EARTH CONTACT アースパネ		1	PHOSPHOR BRONZE りん青銅	t0.25	(S)			SILVER PLATED
1	HOUSING ハウジング		1	PA66 黒			94V-0		

ALL DIMENSIONS IN () ARE FOR REFERENCES ONLY () 印は、参考寸法				TITLE 名称		3.5 DIA PHONE JACK 小形単頭ジャック		ISSUED 出 図	
APPROVED 責任者	CHECKED 照査者	DRAWN 製図者	DESIGNED 設計者	CODE No. コードNo.		YKB21-5349			
				UNIT 単位	DRAWING No. 図番				
				SCALE 尺度	PAGE ページ		REVISION 版数		
				CUSTOMER CODE ユーザーコード					

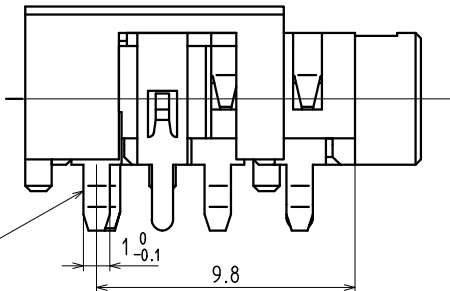
TOHOKU TATSUMI CO.,LTD

REFERENCE DRAWING

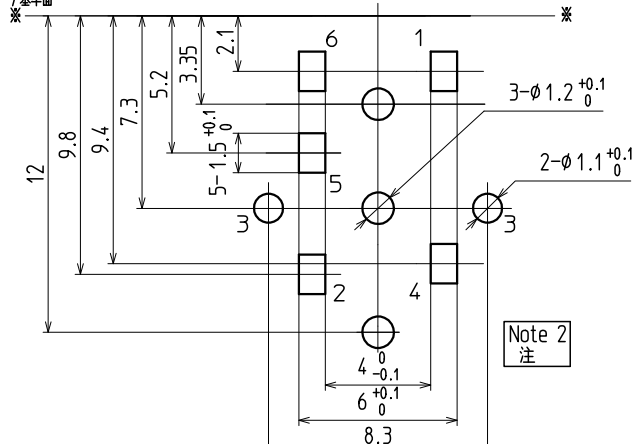
御参考



Circuit
回路図



Reference plane
/基準面



Note 2
注

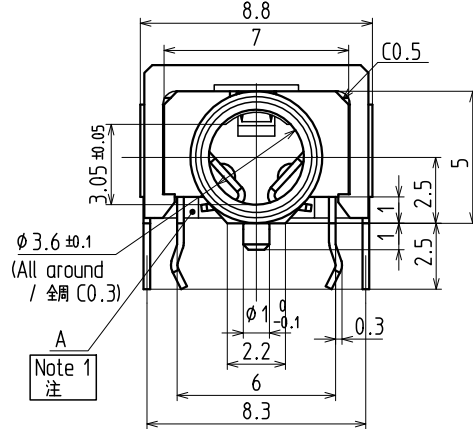
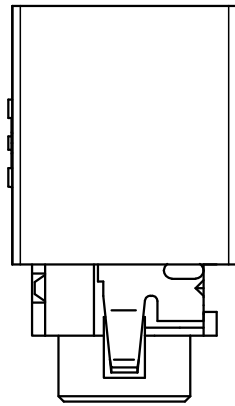
Referential dimensions of PC board holes / 参考基板孔寸法図
(Printed-side view/パターン面)(Tolerance/公差 ALL±0.1) t1.2

TOLERANCE 寸法公差			X
6	under 未満	± 0.3	X
over 以上	6 under 未満	± 0.4	X
over 以上	20 under 未満	± 0.5	X
over 以上		±	X
ANGLE(DEG) 角 度		± 5°	MARK 記号

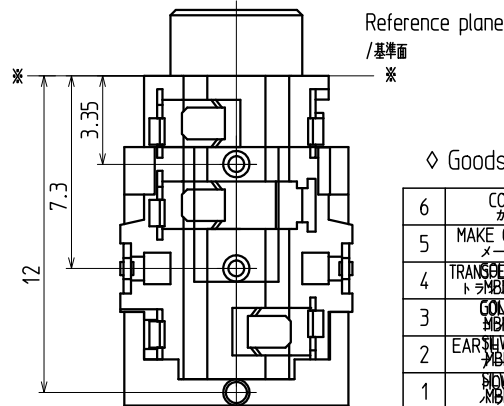
REVISIONS
改訂事項

DATE
日付

SIGN
担当



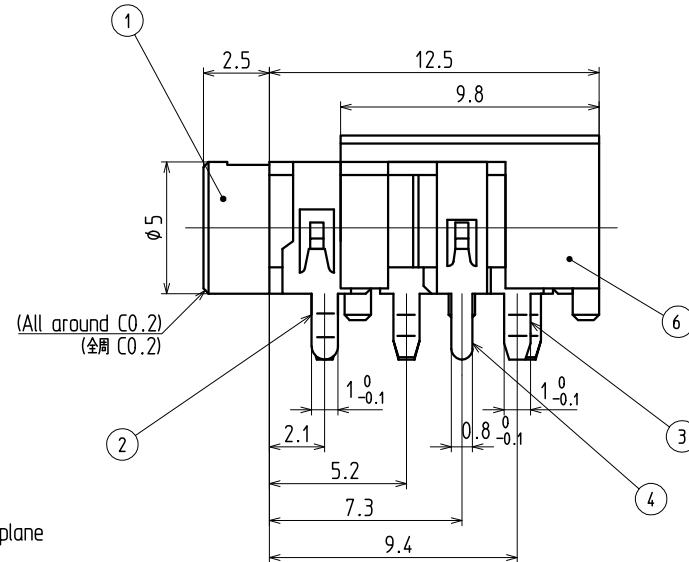
Note 1
注



Reference plane
/基準面

Notes / 注記

1. Take care not to let the solder flow into the part of A when you solder a jack with a soldering iron.
半田ゴテにて半田付けする場合は、A部に半田が流れ込まない様にご注意ください。
2. Use a jig tool to fix the jack to a PCB so that it would not suspend from the PCB when you dip the jack into a soldering bath.
半田槽にてディップする場合は、治具等を用いてジャックの浮きが生じない様にして下さい。
3. In case use P.C board of through holes, don't prepare a land in part side.
スルーホール基板を使用する際は、部品面側にランドを設けない事。
4. When soldering in auto soldering bath, it is suggested to check contact failure, appearance failure, etc. by flux before.
自動半田槽にて半田付けを行う際には、事前にフラックス流入による接触不良、外觀不良等の確認をお願いします。



◇ Goods mass / 製品質量 : About / 約 0.7g

t1.2 type/タイフ
With cover type
カバー付タイプ
3.5 DIA LA7

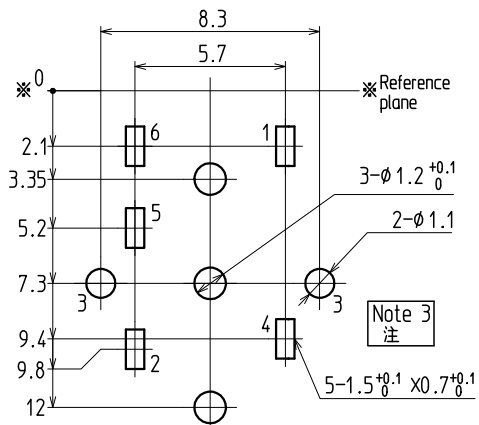
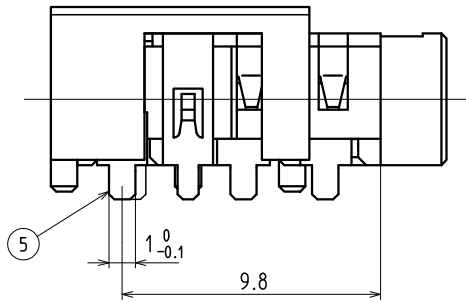
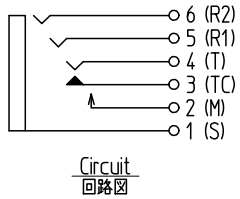
No.	PARTS NAME	CODE No.	Q'TY	MATERIAL	MAKER	No.	UL	FINISH	REMARKS
6	COVER カバー		1	PBT GF15% WHITE 白			94V-0		
5	MAKE CONTACT メークパネ		1	BRASS t0.25 黄銅	(M)			GOLD PLATED	
4	TRANSFER CONTACT トランスファーコンタクト		1	PHOSPHOR BRONZE t0.25 りん青銅	(TC)			GOLD PLATED	
3	CONTACTATED コンタクト		3	PHOSPHOR BRONZE t0.25 りん青銅	(T,R1,R2)			SILVER PLATED	
2	EAR SILVER CONTACT アース銀メッキコンタクト		1	PHOSPHOR BRONZE t0.25 りん青銅	(S)			SILVER PLATED	
1	INSULATED 絶縁メッキ		1	PA66 BLACK 黒			94V-0		

ALL DIMENSIONS IN () ARE FOR REFERENCES ONLY () 印は、参考寸法				TITLE 名称		ISSUED 出 図	
APPROVED 責任者	CHECKED 照査者	DRAWN 製図者	DESIGNED 設計者	3.5 DIA PHONE JACK 小形単頭ジャック			
				CODE No. コードNo.		YKB21-5422N	
				UNIT 単位	DRAWING No. 図番		
				SCALE 尺 度	PAGE ページ		REVISION 版 数
				CUSTOMER CODE ユーザーコード			

TOHOKU TATSUMI CO.,LTD

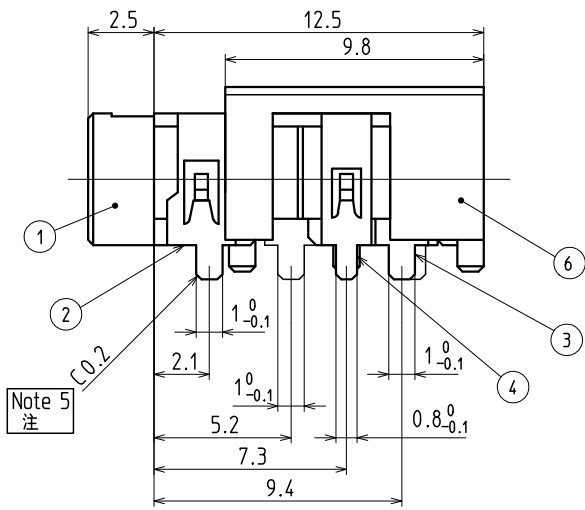
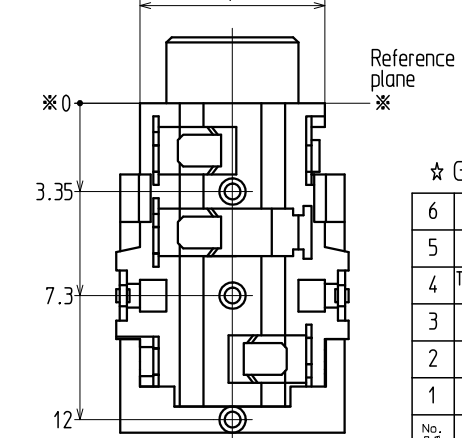
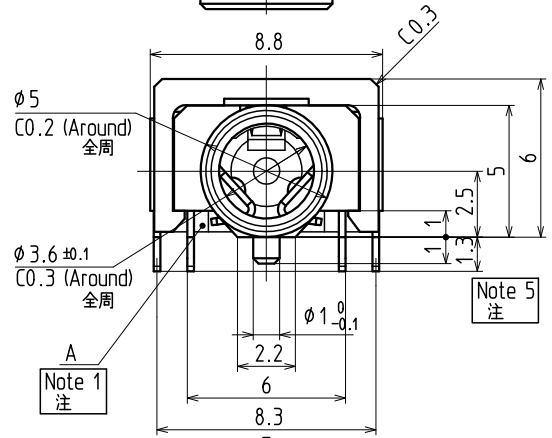
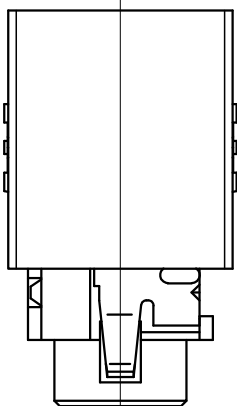
REFERENCE DRAWING

御参考



Dimensions of PC board holes
参考基板孔寸法図

(Tolerance All±0.1)(Printed side-view) t0.8
公差 パターン側



- Notes / 注記
1. Take care not to let the solder flow into the part of A when you solder a jack with a soldering iron.
半田ゴテにて半田付けする場合は、A部に半田が流れ込まない様にご注意ください。
 2. Use a jig tool to fix the jack to a PCB so that it would not suspend from the PCB when you dip the jack into a soldering bath.
半田槽にてディップする場合は、治具等を用いてジャックの浮きが生じない様にして下さい。
 3. In case use P.C board of through holes, don't prepare a land in part side.
スルーホール基板を使用する際は、部品面側にランドを設けない事。
 4. When soldering in auto soldering bath, it is suggested to check contact failure, appearance failure, etc. by flux before.
自動半田槽にて半田付けを行う際には、事前にフラックス流入による接触不良、外觀不良等の確認をお願いします。
 5. The contacts length are 1.3mm, and those have C0.2 at the tip.
本製品の端子長さは、1.3mmであり、その識別としてC0.2を端子先端に有する。

t0.8 type/タイプ
With cover type
カバー付タイプ
3.5 DIA LA7

☆ Goods mass / 製品質量 : About / 約 0.7g.

6	COVER カバー		1	PBT GF15% WHITE 白			94V-0		
5	MAKE CONTACT メークパネ		1	BRASS 黄銅	t0.25	(M)		GOLD PLATED	
4	TRANSFER CONTACT トランスファパネ		1	PHOSPHOR BRONZE りん青銅	t0.25	(TC)		GOLD PLATED	
3	CONTACT コンタクト		3	PHOSPHOR BRONZE りん青銅	t0.25	(T, R1, R2)		SILVER PLATED	
2	EARTH CONTACT アースパネ		1	PHOSPHOR BRONZE りん青銅	t0.25	(S)		SILVER PLATED	
1	HOUSING ハウジング		1	PA66 黒			94V-0		

ALL DIMENSIONS IN () ARE FOR REFERENCES ONLY ()印は、参考寸法				TITLE 名称		3.5 DIA PHONE JACK 小形単頭ジャック		ISSUED 出 図	
APPROVED 責任者	CHECKED 照査者	DRAWN 製図者	DESIGNED 設計者	CODE No. コードNo.		YKB21-5361			
				UNIT 単位	DRAWING No. 図番				
				SCALE 尺度	PAGE ページ		REVISION 版数		
				CUSTOMER CODE ユーザーコード					

TOHOKU TATSUMI CO.,LTD

TOLERANCE 寸法公差		X							
6	under 未満	± 0.3	X						
over 以上	6 under 未満	± 0.4	X						
over 以上	20 under 未満	± 0.5	X						
over 以上		±	X						
ANGLE(DEG) 角 度		± 5°	MARK 記号						
REVISIONS 改訂事項				DATE 日付	SIGN 担当				